



INTEK PLUS

Integrated Measurement System



기업개요

(주)인텍플러스는 3D, 2D 측정 및 검사기술을 기반으로 한 반도체 외관 검사장비 기업입니다.

사업분야는 총 4개로 구성되어 있으며, 반도체 패키지, 메모리 모듈, SSD 외관검사장비 분야의 1사업부, 플립칩 반도체의 서브스트레이트, WLP/PLP 검사장비 분야의 2사업부, OLED / LCD 검사 분야 및 2차 전지 외관검사 분야의 3사업부 입니다.

또한, 스마트팩토리 분야에 진출해 타 업체와 비교해 차별화된 3차원 측정 기술력으로 다양한 검사 분야에서 최적화된 검사 솔루션을 제공하고 있습니다.

가장 큰 기술력으로는 타사 대비 정밀한 측정 능력으로 공정상의 품질을 확보할 수 있는 능력을 지니고 있으며, 이러한 기술력은 200건 이상의 특허와 지적재산권, 국제표준 ISO인증을 보유함으로써 국제적으로도 인정받고 있습니다.

현재는 자사의 장비를 세계화하기 위해 4개국에 전문성을 지닌 인재를 바탕으로 해외지사를 설립하여, 다양한 시장 개척 활동을 하며 전세계 150여개의 고객사에 장비 수출을 진행하고 있습니다.

기업 연력

- 1995 (주)인텍엔지니어링 설립
- 1997 국내 최초로 비접촉식 모아레 3차원 스캐너 개발
- 2000 (주)인텍플러스로 법인명칭 변경
- 2001 ISO9001획득 (K-1355)
- 2002 CE인증 획득
- 2003 반도체 칩 외관검사장비 개발 [iPIS-200]
- 2007 중국 소주(Suzhou) 사무소 설립
- 2009 iSOLAR Series / iPIS-L Series PKG장비 개발
- 2010 5백만불 수출의탑 (한국무역협회)
- 2011 KOSDAQ 시장 상장
- 2012 대만지사 설립
- 2016 반도체 Flip-chip BGA 기판 검사 장비 개발 [iSIS-NBGA]
- 2017 미국지사 설립
- 2019 반도체 칩 외관 검사 장비 신규 모델 개발 [iPIS-580HX, iPIS-340HX]
- 2020 유망중소기업 선정
- 2021 코스닥 라이징 스타 선정 (한국거래소)
- 2022 인텍플러스 신공장 완공
- 2023 반도체미드엔드 검사장비 세계일류상품 선정 (산업통상 자원부)

장비소개

(주)인텍플러스는 고정밀 Vision 기술로 Wafer, Substrate의 Flip-chip Bump 검사 솔루션을 제공하고 있습니다.

Chiplet으로 더 커지는 Package, 더 미세한 Bump로 인해 Die Attachment 수율을 위한 Bump 3D의 기준이 높아지고 있습니다.

(주)인텍플러스의 3D Vision은 High-end Package 공정에서 검증되었으며, iSIS-NBGA는 FC-BGA Bump 검사의 Best Known Method 입니다.

